



2004マイクロエレクトロニクスショー 最先端実装技術・パッケージング展」開催報告

社団法人エレクトロニクス実装学会
展示委員会

1. 総括

2004 マイクロエレクトロニクスショー「最先端実装技術・パッケージング展」が、4月14日(水)～16日(金)の3日間、東京流通センター・アールンEホールで開催されました。

本展示会は高度情報機器や小型モバイル機器などの実現を支える、最新のエレクトロニクス実装技術である基板、材料、部品、装置の開発や設計に携わる第一線技術者を中心とした最も歴史ある専門展示会です。

今回も国内唯一の実装国際会議である2004 ICEPと同時に開催し、国内外から総勢10,000名の来場者を迎え、成功裏に終えることが出来ました。

第一ホテル東京シーフォートで開催された2004 ICEPでは、世界各国から最先端実装、MEMS、SIP、Pbフリーや回路設計・テストを含む84件もの最新研究論文が3日間に亘って発表されました。



本展示会では学会主催である特色を生かして、出展社による「製品技術セミナー」、「特別講演」ならびに「実装研究セミナー」を他に先駆けて実施して参りました。「実装研究セミナー」では、最新の関心事であるPbフリー、環境調和型材料および実装材料・技術に関し、双方向で活発な討議が展開されました。「製品技術セミナー」は、19社から微細接続材料、Pbフリー導電材料、検査・信頼性試験など豊富な情報が発信され、延べ1,500名超、「特別講演」3テーマを含めると約2,000名の他に類を見ない聴講者であふれ、新技術に対する真摯な探究

心はまさに新たな飛躍につながるものと確信することができました。

厳しい経済環境ながらも回復基調が見え始めた景気動向の中、たゆまない実装技術進化という時代の要請に応えるべく多くの出展社から寄せられた熱意に感謝申し上げます。

当学会では来年度の展示会を同会場で開催いたします。新たな企画で臨むべく一層の努力を重ねて参る所存ですので、ご出展いただいた皆様、ご来場いただいた皆様ならびに関係各位のご理解とご支援を心よりお願い申し上げます。

2. 展示会実績

東京流通センター会場で4回目を迎えるに至り、ゆとりあるスペースを活用した装置類の展示が数多く見られるようになりました。従来、どちらかといえば基板、材料、部品に偏りがちだった本展示会もバランスが整ったことで、正にパッケージング展に相応しいイベントとして広範な情報を提供することができました。

(1) 出展規模

展示会へのニーズも多様化を余儀なくされている中、昨年比で5社減となりましたが、高度最先端技術の再構築意欲も年々高まっており新たなインフラともなるべき多数のご出展をいただきました。改めて御礼申し上げます。

A展示	: 33社50小間
B展示	: 18社18小間
情報・大学コーナー	: 6団体



下記のご出展をいただきました。

旭硝子(株)	東レ(株)
イー・エス・エル日本(株)	中村製作所(株)
ウシオ電機(株)	ナミックス(株)
(株)イー・イー・ティー ジャパン	(株)日刊工業新聞社
奥野製薬工業(株)	日本シイエムケイ(株)
オムロン(株)	日本電気硝子(株)
(株)技術調査会	ニホンハンタ(株)
京セラSLCテクノロジー(株)	日本ペイン(株)
京都エレクトックス(株)	日本ペルロックス(株)
(株)工業調査会	日本ミクロン(株)
(株)コベルコ科研	(株)ネットブレイン
(株)サンエイテック	(株)ノリタケカンパニーリミテド
サンユレック(株)	ハインソル(株)
山陽精工(株)	Pac Tech (Packaging Technologies GmbH) / 長瀬産業(株)
CQ出版(株)	福田金属箔粉工業(株)
澁谷工業(株)	(株)フジクラ
昭栄化学工業(株)	藤倉化成(株)
(株)住友金属エレクトロデバイス	ヘンケルジャパン(株)
住友金属鉱山(株)	(株)ミスズ工業
千住金属工業(株)	ミヨ電子(株)
双日マシナリー(株) / (株)ユタカ	武蔵エンジニアリング(株)
太陽誘電(株)	(株)ムラカミ
テクノアルファ(株)	(株)メイコー
(株)デンタルメディア・ネットワーク	大和電機工業(株)
TechSearch International Inc.	
デュボン(株)	

(2)出展内容

「環境配慮技術が集結！」というテーマの下、Pbフリー材料やハロゲンフリー基板など環境配慮型負荷物対策部品・材料など正にグローバルスタンダード化を意図した展示物のほか、超微細加工技術、装置、材料といった設計の自由度とコストパフォーマンスをアピールする提案型出展が勢揃いし、来場者にとっては良きロードマップにもなりました。

(3)来場者数

来場者は延べ 10,004 名を数えましたが、残念ながら前年実績を 17%下回る結果となりました。



3.実装研究セミナー

本イベントは当学会が他に先駆けて企画実施しているセミナーです。受身であった従来型セミナーは、聴講者

にとっては十分に理解できないばかりか質問も限られ、それ以上の展開をもたらさないケースが殆どでした。当セミナーでは、コーディネーターがリードしながら最新で関心の高いテーマに絞り双方向で十分に討議できる場を設けることによって相互理解を深め、新産業創出ともいふべき技術革命が我が国、広くはグローバルにもたらされることを意図するもので、今回も多数の参画をいただきました。

発表件数	: 6 件
聴講者数	: 304 名 (平均 51 名)

講演内容

14日	セイコーエプソンにおける低温鉛フリーはんだ実用化に向けた検討 【講演者】セイコーエプソン(株) 生産技術開発部 西山 佳秀 【コーディネーター】セイコーエプソン(株) 小林 高弘
	HDP User Group 鉛フリープロジェクト成果報告 【講演者】富士通(株) テクノロジセンター 菊池俊一 【コーディネーター】日本シイエムケイ(株) 猪川 幸司
15日	面実装用銀エポキシ接着剤の材料科学的特性の検討 【講演者】住友金属鉱山(株) 技術本部 小日向 茂 【コーディネーター】旭硝子(株) 石丸 政行
	新しい塗膜形成機構による低温硬化・高導電性ペースト 【講演者】藤倉化成(株) 電子材料事業部 本多 俊之 【コーディネーター】デュボン(株) 梁 守謹
16日	受動素子・能動素子内蔵配線板技術の最新動向と課題 【講演者】インターコネクション・テクノロジーズ(株) 宇都宮久修、矢島 龍介 【コーディネーター】日本シイエムケイ(株) 猪川 幸司
	SIP(System in Package)の先端実装技術と将来像 【講演者】(株)日立製作所 モノづくり技術事業部 西 邦彦 【コーディネーター】デュボン(株) 梁 守謹

4.特別講演

毎回、製品技術セミナーのビッグイベントとして大学や国家プロジェクトさらには業界の代表を招いて最先端技術・情報に関する講演を実施しております。

発表件数	: 3 件
聴講者数	: 440 名 (平均 147 名)

講演内容

14日	電子機器の環境対策最前線 - 欧州の環境規制を中心に - (株)ユーエルエーベックス ビジネス開発部 青木 正光
15日	MEMS の現状と将来展望 独立法人産業技術総合研究所 機械システム研究部門 集積機械研究グループ 前田龍太郎
16日	実装技術の未来 京セラSLCテクノロジー(株) 塚田 裕

5.製品技術セミナー

本展示会出展の特典としてすっかり定着しています。本セミナーは 25 分間の持ち時間と共に予稿集を活用い

ただき、効率よく運営しております。今回は以下の最新技術が披露され、多くの聴講者の関心を引くことができました。

発表件数(会社数)	: 19件
聴講者総数	: 1,535名(平均81名)

発表内容

14日	鉛フリーはんだ対応銀/白金導体ペースト 京都エレックス(株) 技術開発部 三好 宏昌
	高密度実装用 Pre-applied アンダーフィル 材料 ヘンケルジャパン(株) TTE 事業部 住安 健一
	レーザー照射を用いためっき加工技術 大和電機工業(株) 要素技術部 野口 真
	80 μmの超微量鉛フリーハンダ塗布を実現する最新の塗布技術 武蔵エンジニアリング(株) 総合企画室 富山 和照
	ミス工業の実装サービスの紹介 (株)ミス工業 営業部 林 史朗
	リタケ次世代Agペーストの紹介 リタケ機材(株) 技術部 富田 秀幸
	テックサーチ・インターナショナル社による情報提供 TechSearch International Inc. J. Vardaman
15日	導電接着剤の用途展開 ナミックス(株) 事業本部 ユニメックグループ 駒形 道典
	マイクロ接合部の評価技術 (株)コベルコ科研 専門事業所 物理解析室 猪口 憲一
	はんだ代替導電性接着剤の技術動向 藤倉化成(株) 電子材料事業部 技術部技術 2課 渡邊 聡
	高温観察装置による鉛フリーはんだのぬれ性評価 山陽精工(株) 開発事業本部 西室 将
	導電性接着剤 「ドーデン」新製品について」 ニホンハンダ(株) 営業部 根本 正一
	ノンフロータイプアンダーフィル 剤 サンコレック(株) 半導体事業部 永井孝一良
極薄ビルドアップ配線板技術の半導体サブストレートへの応用 日本シイエムケイ(株) 技術開発統括部 加藤 義尚	
16日	ダイシング工程の新技術 ハインル(株) 営業部 秋山 昌海
	100 μm クラス BGA ボール分級技術 (株)ユタカ 安田 正俊
	中性無電解ニッケル/金プロセス(NNP プロセス) 奥野製薬工業(株) 表面技術研究所 下地 輝明
	デュボンの受動部品内蔵基板材料 デュボン(株) 電子材料部 仲島 直人
	Low Cost Bumping for Wafers - Electroless Ni/Au and Laser Equipment - Pac Tech Thomas Oppert



6. 今後の発展に向けて

本展示会は、半導体および周辺実装技術の総合展示会としてスタートし、優に24年の歴史を誇っています。関係各位の熱意と努力により、欧米におけるIMAPSと並び最先端高密度実装技術の探求と具現化提案あるいは情報発信の場として重要な使命を担って活動しているものです。

ご承知のとおり本ショーは最先端のエレクトロニクス実装技術に特化し、しかも専門技術者や研究者を中心にした展示会ということで規模や来場者数を他の展示会と比較できるものではありませんが、限りなく“場”を提供するという責務を全うするためさらなる充実を図って参る所存です。

今後とも親しまれ、信頼される展示会としてより広範な出展参画が得られるよう関係各位の暖かいご理解とご支援を心よりお願いいたします。

2004 マイクロエレクトロニクスショー 最先端実装技術・パッケージング展

主 催： 社団法人エレクトロニクス実装学会（JIEP）
開催場所： 東京流通センター（TRC） アールンEホール
セミナー会場： センタービル第2，第6会議室
会 期： 2004年4月14日(水)～16日(金)

展示委員会および展示実行委員会

展示委員長： 小林 高弘（セイコーエプソン株式会社）
展示実行委員長： 今田 悟（株式会社エヌエフ回路設計ブロック）
展示委員会顧問： 傳田 精一（長野県工科短期大学校）
展示委員会顧問： 關 亀春（日本シイエムケイ株式会社）
展示委員会顧問： 深水 一磨（昭栄化学工業株式会社）
実行副委員長： 猪川 幸司（日本シイエムケイ株式会社）
実行副委員長： 石丸 政行（旭硝子株式会社）
実行委員： 妹尾 明（京セラケミカル株式会社）
実行委員： 寺尾 博（日本電気株式会社）
実行委員： 梁 守謹（デュポン株式会社）
実行委員： 齋藤 謙一（ナミックス株式会社）
実行委員： 長井 幸子（日本シイエムケイ株式会社）